

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成24年2月2日 (2012.2.2)

【公開番号】特開2010-58507(P2010-58507A)

【公開日】平成22年3月18日 (2010.3.18)

【年通号数】公開・登録公報2010-011

【出願番号】特願2009-201723(P2009-201723)

【国際特許分類】

**B 4 1 J 2/175 (2006.01)**

【F I】

B 4 1 J 3/04 1 0 2 Z

【手続補正書】

【提出日】平成23年12月13日 (2011.12.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

固体インクを溶融するように構成される溶融プレートと、  
前記溶融プレートの温度を感知するように構成される温度センサと、  
前記溶融プレート上に配置され、前記溶融プレートに対して前記温度センサを接続する  
ように構成される取付台であって、マイカ層と、第 1 のポリイミド層と、第 2 のポリイミ  
ド層とを含み、当該第 1 のポリイミド層が当該第 2 のポリイミド層に近接して配置される  
取付台と、  
を備える、固体インク溶融装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の固体インク溶融装置において、  
前記マイカ層が前記溶融プレートに近接して配置され、前記第 2 のポリイミド層が前記  
温度センサに近接して配置される固体インク溶融装置。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の固体インク溶融装置において、  
感圧接着剤を使用して前記取付台を前記溶融プレートに接続する固体インク溶融装置。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の固体インク溶融装置において、  
さらに、前記第 1 のポリイミド層を前記第 2 のポリイミド層に接続する感圧接着剤を含  
む、固体インク溶融装置。

【請求項 5】

請求項 1 に記載の固体インク溶融装置において、  
さらに、前記溶融プレートに熱を与えるように構成されるヒータと、  
前記温度センサに接続され、該温度センサによって感知される温度に基づいて、前記ヒ  
ータに供給される電力を調節するように構成されるコントローラと、  
を備える固体インク溶融装置。

【請求項 6】

請求項 1 に記載の固体インク溶融装置において、  
前記温度センサがサーミスタを含む固体インク溶融装置。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の固体インク溶融装置において、  
前記温度センサが前記溶融プレートの表面から取り外され、スプリングアームを介して  
前記取付台に接続されている固体インク溶融装置。

【請求項 8】

固体インクプリンタにおいて、温度センサを溶融プレートに取り付ける方法であって、  
マイカ層と、第 1 のポリイミド層と、第 2 のポリイミド層とを含む可撓性の取付部材で  
あって、前記第 1 のポリイミド層が前記第 2 のポリイミド層に近接して配置される取付部  
材を準備し、

前記取付部材の前記マイカ層を、前記溶融プレートに接続し、  
前記温度センサを前記第 2 のポリイミド層に接続する方法。

【請求項 9】

装置基板と、  
前記装置基板上に設けられた加熱部材と、  
前記加熱部材の少なくとも一部に設けられたマイカ層と、  
前記マイカ層の少なくとも一部に接続された第 1 のポリイミド層と、  
前記第 1 のポリイミド層に接続された第 2 のポリイミド層と、  
前記第 2 のポリイミド層に接続された温度センサと、  
を含む加熱装置。

【請求項 10】

請求項 9 に記載の加熱装置において、  
さらに、前記第 1 のポリイミド層と前記第 2 のポリイミド層とを含む複数のポリイミド  
層を備え、該第 1 のポリイミド層が前記マイカ層と前記第 2 のポリイミド層との間に配置  
されている加熱装置。